

第8回 シリコン材料の科学と技術 フォーラム 2018 (岡山)

2018年

11月18日(日)~21日(水)

(受付開始18日16:00 ~ 最終日14:45)

岡山大学創立五十周年記念館 (津島キャンパス)

目的：1. 情報系LSIデバイス、パワーデバイス、イメージセンサ、太陽電池などの半導体デバイスに使われるシリコンウェーハと関連半導体材料の製造技術、評価技術、処理技術に関わる基礎研究と応用研究の交流。

2. 若手研究者、技術者の教育と活性化、及び国際活動力の向上。

3. 直面する問題をブレークスルーするための全員参加の討論。

参加費： 一般：35,000円, 学生：15,000円

主催：(独)日本学術振興会 結晶加工と評価技術 第145委員会, シリコン材料の科学と技術フォーラム2018 実行委員会

参加申込み締切り：10月19日(金)

参加申込み方法：本フォーラムウェブサイトの大会情報のページから専用用紙「シリコンフォーラム2018 参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記入して、下記の参加申込み先までメール添付にてお申し込み下さい。

発表申込み締切り：9月28日(金)

発表申込み方法：上記参加申込書に、発表に関する情報も記載して、下記の発表申込み先までメール添付にてお申し込み下さい。なお、ウェブ掲載の要領に従って、10月19日(金)までにプロシーディング原稿を提出してください。

実行委員会委員長：末岡浩治(岡山県立大学)

同副委員長：太子敏則(信州大学) 山下善文(岡山大学) 深田直樹(物質・材料研究機構) 棚橋克人(産業技術総合研究所)

同アドバイザー：田島道夫(明治大学) 柿本浩一(九州大学) 金田寛(九州工業大学) 村上進(茨城大学) 鹿島一日兒(東京工業大学)

同海外アドバイザー：Gudrun Kissinger (IHP) Eddy Simoen (IMEC)

同委員：栗田一成(SUMCO) 高橋秀和(キヤノン) 小椋厚志(明治大学) 鶴田健二(岡山大学) 上田修(金沢工業大学)

大谷昇(関西学院大学) 酒井朗(大阪大学) 志村考功(大阪大学) 佐俣秀一(SUMCO) 山本秀和(千葉工業大学)

表和彦(リガク) 佐野泰久(大阪大学) 西澤伸一(九州大学) 上殿明良(筑波大学) 土田秀一(電力中央研究所)

竹野博(信越半導体) 宇佐美徳隆(名古屋大学)

関口隆史(物質・材料研究機構) 石川由加里(ファインセラミックスセンター)

藤森洋行(グローバルウェーハズ・ジャパン) 泉妻宏治(グローバルウェーハズ・ジャパン)

共催：(公社)応用物理学会中国四国支部

参加・発表申込み先：シリコン材料の科学と技術フォーラム2018 実行委員会 E-mail: siforum2018@okayama-u.ac.jp

問い合わせ先：〒701-1152 岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学大学院 自然科学研究科 山下善文

TEL: 086-251-8231, FAX: 086-251-8231 E-mail: yoshifumi.yamashita@okayama-u.ac.jp

または 〒719-1197 岡山県総社市窪木111 岡山県立大学 情報工学部 末岡浩治

TEL: 0866-94-2136, FAX: 0866-94-2199 E-mail: sueoka@c.oka-pu.ac.jp

ホームページ: <http://www.ec.okayama-u.ac.jp/~dm/siforum/>